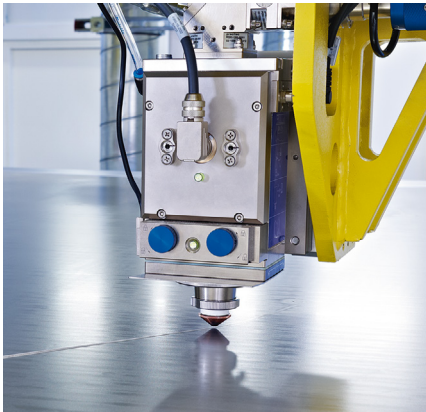


PLATINENSCHNEIDSYSTEME – GRUNDLAGEN. MESSERSCHARF.



Laserkopf.



Platinen-Schwenkwerkzeug.

ZIELSETZUNG

Die Anforderungen bzgl. Material, Schnittgeometrie und Produktionsleistung bestimmen den Schneidprozess. Um das volle Potenzial der Platinenschneidsysteme nutzen zu können, ist ein Grundverständnis der Zusammenhänge und Möglichkeiten wichtig.

Sie lernen Lösungen, um flexibel auf aktuelle und zukünftige Bedürfnisse zu reagieren. In diesem Seminar werden wir Ihnen Faktoren aufzeigen, wie die Gesamtanlageneffektivität einer Platinenschneidanlage durch den Schneidprozess beeinflusst wird.

INHALT

- 4- oder 2-Säulen Trenneinrichtungen zur Produktion von Platinen durch Grad-, Bogen- oder Formschnitt
- Formfreies Schneiden durch eine vollautomatischen Laser Schneideinrichtung
- Logistisch vor- und nachgelagerte Prozesse und deren Einflussgrößen
- Einwirkung der Richtprozesse auf die Verarbeitung des Bandmaterials und des geschnittenen Bauteils
- Die Platinausschleusung im Kontext zur Produktionsleistung
- Technologie-Update

ZIELGRUPPE

- Leiter von Funktionseinheiten aus dem Bereich Anlagentechnik
- Anwender und Entscheider aus dem Bereich Produktion und Instandhaltung
- Einrichter
- Werkzeugmacher
- Planer/Optimierer
- Mitarbeiter der Fertigungs- und Presswerkplanung
- Technischer Einkäufer

TRAINER

Andreas Schmidt

VORAUSSETZUNGEN

Technisches Grundverständnis

TERMINE/ORT

21.02.2018
Automation TechCenter
Heßdorf

19.09.2018
Automation TechCenter
Heßdorf

✉ Individuelle Termine auf Anfrage

DAUER

1 Tag
09.00 – 16.30 Uhr

SEMINARGEBÜHR

650,- Euro pro Person
zzgl. MwSt.

ANSPRECHPARTNERIN

Pia Stier
Telefon +49 7161 66-7721
pia.stier@schulergroup.com

ANMELDUNG

Seminarnummer: GPS | Dieses Seminar kann auch als Teil des Pakets 4 gebucht werden. Mehr Infos auf Seite 11 oder unter www.schulergroup.com/Forming_Academy.